

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-034

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用承销方式，向不特定合格投资者公开发行人可转换公司债券1,175万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金117,500.00万元，坐扣承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为116,600.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2025年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用301.67万元后，公司本次募集资金净额为116,298.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕6-4号）。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年3月31日余额	备注
兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	70,000.00	-	已注销
中信银行上海分行	8110201011501885643	20,000.00	-	已注销
交通银行上海张江支行	310066865013009418191	26,600.00	-	已注销
招商银行无锡分行	511903003310018	-	-	已注销
交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	-	-	已注销
合计		116,600.00	-	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 301.67 万元，系公司 2025 年使用自有资金支付保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用所致。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

### （一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

### （二）前次募集资金投资项目置换情况说明

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	58,938.02	58,938.02	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	18,488.01	18,488.01	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	27,500.00	180.07	180.07	2025 年 5 月 28 日	2025 年 4 月 27 日

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，

但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

2、偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

部分募投项目达到预定可使用状态后尚未构成完整会计年度，故产生效益低于 20%。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 八、闲置募集资金的使用

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

#### 募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 4 月 15 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品	2025年4月27日	2026年4月26日	2025年4月27日

### 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7天通知	16,600.00	2025/4/30-2025/5/12	0.53
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6-2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3-2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7-2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7-2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8-2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	7天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86
合计			87,600.00[注]		61.05

[注]与计划进行现金管理的金额 40,000.00 万元差异系循环购买理财产品所致

### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至 2026 年 3 月 31 日，募集专户均已注销，节余募集资金 8.17 万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116,298.33						已累计使用募集资金总额：116,361.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2025 年：116,361.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,000.00	70,000.00	70,018.42	18.42[注 1]	2025 年 9 月
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.00	20,000.00	20,000.10	0.10[注 1]	2024 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流	偿还银行贷款及补充流	27,500.00	27,500.00	26,343.18	27,500.00	27,500.00	26,343.18	-1,156.82[注 2]	不适用

	动资金项目	动资金项目								
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

[注 1]项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致

[注 2]本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决



附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	不适用	项目达产后， 可实现年平均 销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	不适用	项目达产后， 可实现年平均 销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 2]	32,463.57	是
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价

[注 2]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。2025 年为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益